



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE TXC-269

TOHMIDE TXC-269 为中低黏度、高分子量热熔型聚酰胺树脂，主要针对低压模塑成型所设计开发，可溶于一般醇类或苯类之混合溶剂，其树脂主要特性为脱模成型时间适中、物性上具有优良的机械强度，及耐热性、柔韧性佳等。可应用于多种材质的接着、电子零件保护、汽车工业、电池封装。

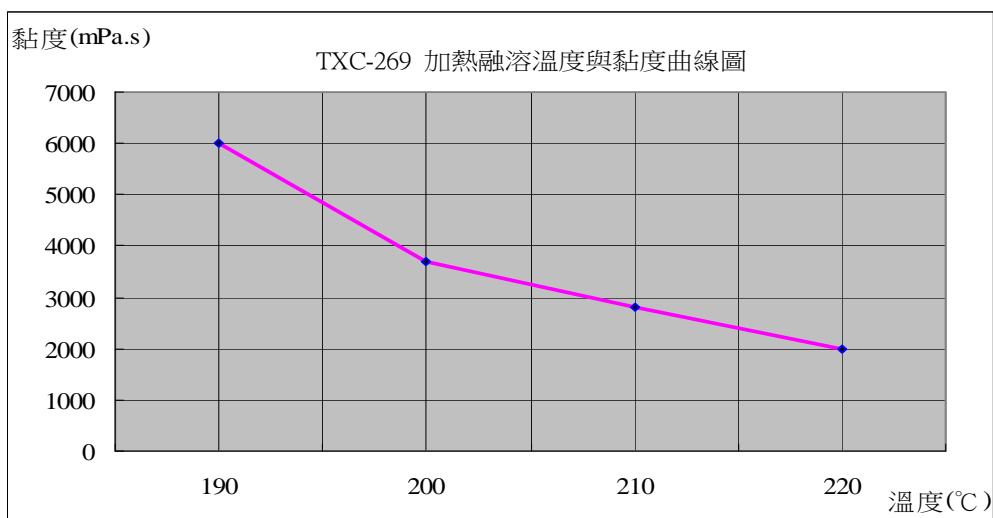
1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
软化点 (°C)	: 170~180
黏度 (mPa.s / 200°C)	: 3,000 ~ 4,000
色数 (Gardner)	: 10 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 8 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 1.5 以下

2. 物理特性(机械性质)

抗张强度 (MPa)	: >10	(ASTM D-638-00)
抗张伸长率 (%)	: >400	(ASTM D-638-00)
吸水率(%)	: 0.5	
操作温度范围(°C)	: 200~220	

3. 黏度变化曲线图



4. 包装方式

20 公斤装编织袋

5. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。